

2022年中国半导体封装市场分析报告- 市场全景评估与发展定位研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2022年中国半导体封装市场分析报告-市场全景评估与发展定位研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202112/566191.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》

（GB/T4754-2017），半导体封装设备及模具行业属于“专用设备制造业（C35）”

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，半导体封装设备及模具属于“1.新一代信息技术产业-1.2电子核心产业-1.2.4集成电路制造-3562半导体器件专用设备制造-封装设备”

1、行业主管部门

半导体封装设备及模具行业主管部门为国家工信部、发改委。

国家工信部主要负责拟订、实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动产业结构战略性调整和优化升级，推动重大技术装备发展和自主创新等。国家发改委主要负责制定产业政策，提出中长期产业发展规划和指导性意见等，履行宏观调控职能。

2、行业监管体制

半导体封装设备及模具行业自律组织为中国模具工业协会、中国建筑金属结构协会塑料门窗及建筑装饰制品分会、中国半导体行业协会等。

中国模具工业协会是国家民政部核准登记注册、具有社团法人资格的模具行业全国性社会团体，承担模具制造行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、行业自律管理、行业内信息交流以及协助有关部门制定（修订）模具产品的行业技术标准、规范等。

中国建筑金属结构协会塑料门窗及建筑装饰制品分会隶属于住房和城乡建设部领导下的国家一级协会—中国建筑金属结构协会，现有会员单位近600家，会员单位包含了塑料门窗、塑料型材、五金件、组装设备、模具生产企业以及科研检测机构、大专院校、地产开发等单位；目前主要根据住房和城乡建设部有关文件要求，以协助政府、服务行业、服务企业等为主要工作内容。

中国半导体行业协会是由从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的相关的企、事业单位自愿结成的行业性、全国性、非营利性的社会组织，是半导体行业自律管理机构。

行业协会在国家工业和信息化部的指导和管理下，负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。协会下设集成电路分会、半导体封装分会、集成电路设计分会等六个分会。

3、行业主要法律法规、产业政策

为优先发展和重点支持我国智能制造装备行业的发展，为促进行业持续、健康发展，国家相关部门先后出台了一系列鼓励半导体封装设备及模具行业发展的法规及政策，具体政策法规如下：

序号

时间

发文部门

名称

主要内容

1

2010年

国务院

《国务院关于加 快培育和发展战 略性新兴产业的 决定》

重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业，发展的重点方向 包括以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备

2

2012年

工业和信息

化部、科技 部、财政 部、国务院 国资委

《重大技术装备 自主创新指导目 录（2012年 版）》

“大型及精密、高效塑料模具， 铸造模具，轮胎模具，精密、高效多工位级进冲压模具及超高强度钢板热成形模具以及为C级轿车整车车身成形生产配套的覆盖件及车身模具”等被列入其中

3

2012年

国务院

《“十二五”国 家战略性新兴产 业发展规划》（国发[2012]28号）

围绕重点整机和战略领域需求，大力提升高性能集成电路产品自主开发能力，突破先进和特色芯片制造工艺技术， 先进封 装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，加强新一代半导体材料和器件 工艺技术研发，培育集成电路产业竞争新优势

4

2014年

工信部

《国家集成电路 产业发展推进纲 要》

到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，封装测试技术达到国际领先水平，关键装备和材料进入国际采购 体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系；到2030年，集成电路产 业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展

5

2015年

国务院

《中国制造2025》

部署全面推进实施制造强国战略，为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，提出开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快增材制造等前沿技术和装备的研发。“掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力。形成关键制造装备供货能力”

6

2016年

质检总局、国家标准委、工业和信息化部

《装备制造业标准化和质量提升规划》

落实《中国制造2025》的部署和要求，发挥标准化和质量工作对装备制造业的引领和支撑作用，推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革，促进产品产业迈向中高端，建设制造强国、质量强国

7

2016年

国务院

《国务院关于印

发“十三五”国家信息化规划的通知》

大力推进集成电路创新突破。加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片设计研发部署

8

2017

年

国家发改委、商务部

《外商投资产业指导目录（2017年修订）》

与模具行业相关的产品集中在鼓励类，包括：1）金属制品模具（铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具）设计、制造；2）汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；3）精密模具（冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）设计与制造；4）非金属制品模具设计与制造

9

2017年

科技部

《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》

优化产业结构，推进半导体器件、光通讯器件、MEMS（微机电系统）器件、功率

电子器件、新型显示、半导体照明、高效
技术突破和应用

10

2018年

工信部、国家标准化管理委员会

《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》

针对智能制造标准跨行业、跨领域、跨专业的特点，立足国内需求，兼顾国际体系，建立涵盖基础共性、关键技术和行业应用等三类标准的国家智能制造标准体系……深化智能制造标准国际交流与合作，提升标准对制造业的整体支撑作用……

11

2019年

国家发改委

《产业结构调整指导目录（2019年本）》

非金属制品精密模具设计、制造；大型模具、精密模具、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具等列入鼓励类

12

2019年

工业和信息化部

《工业企业技术

改造升级投资指南（2019年版）》

10.模具。……超大规模集成电路封装模具、精密医疗器械模具；塑料异型材共挤及高速挤出模具；高档模具标准件和智能化模具集成制造单元……

13

2021年

全国人大

《中华人民共和国

国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

制定实施战略性科学计划和科学工程，瞄准前沿领域。其中，在集成电路领域，关注集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展

14

2021年

国务院

《2030年前碳达峰行动方案》

加快提升建筑能效水平。加快更新建筑节能、市政基础设施等标准，提高节能降碳要求。加强适用于不同气候区、不同建筑类型的节能低碳技术研发和推广，推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展

资料来源：观研天下整理(YYJ)

观研报告网发布的《2022年中国半导体封装市场分析报告-市场全景评估与发展定位研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章2018-2022年中国半导体封装行业发展概述

第一节 半导体封装行业发展情况概述

一、半导体封装行业相关定义

二、半导体封装行业基本情况介绍

三、半导体封装行业发展特点分析

四、半导体封装行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、半导体封装行业需求主体分析

第二节 中国半导体封装行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、半导体封装行业产业链条分析

三、产业链运行机制

（1）沟通协调机制

（2）风险分配机制

（3）竞争协调机制

四、中国半导体封装行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国半导体封装行业生命周期分析

一、半导体封装行业生命周期理论概述

二、半导体封装行业所属的生命周期分析

第四节 半导体封装行业经济指标分析

一、半导体封装行业的赢利性分析

二、半导体封装行业的经济周期分析

三、半导体封装行业附加值的提升空间分析

第五节 中国半导体封装行业进入壁垒分析

一、半导体封装行业资金壁垒分析

二、半导体封装行业技术壁垒分析

三、半导体封装行业人才壁垒分析

四、半导体封装行业品牌壁垒分析

五、半导体封装行业其他壁垒分析

第二章2018-2022年全球半导体封装行业市场发展现状分析

第一节 全球半导体封装行业发展历程回顾

第二节 全球半导体封装行业市场区域分布情况

第三节 亚洲半导体封装行业地区市场分析

一、亚洲半导体封装行业市场现状分析

二、亚洲半导体封装行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲半导体封装行业市场前景分析

第四节 北美半导体封装行业地区市场分析

一、北美半导体封装行业市场现状分析

二、北美半导体封装行业市场规模与市场需求分析

三、北美半导体封装行业市场前景分析

第五节 欧洲半导体封装行业地区市场分析

一、欧洲半导体封装行业市场现状分析

二、欧洲半导体封装行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲半导体封装行业市场前景分析

第六节2022-2027年世界半导体封装行业分布走势预测

第七节2022-2027年全球半导体封装行业市场规模预测

第三章 中国半导体封装产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国半导体封装行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国半导体封装产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国半导体封装行业运行情况

第一节 中国半导体封装行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国半导体封装行业市场规模分析

第三节 中国半导体封装行业供应情况分析

第四节 中国半导体封装行业需求情况分析

第五节 我国半导体封装行业细分市场分析

1、细分市场一

2、细分市场二

3、其它细分市场

第六节 中国半导体封装行业供需平衡分析

第七节 中国半导体封装行业发展趋势分析

第五章 中国半导体封装所属行业运行数据监测

第一节 中国半导体封装所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国半导体封装所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国半导体封装所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2018-2022年中国半导体封装市场格局分析

第一节 中国半导体封装行业竞争现状分析

一、中国半导体封装行业竞争情况分析

二、中国半导体封装行业主要品牌分析

第二节 中国半导体封装行业集中度分析

一、中国半导体封装行业市场集中度影响因素分析

二、中国半导体封装行业市场集中度分析

第三节 中国半导体封装行业存在的问题

第四节 中国半导体封装行业解决问题的策略分析

第五节 中国半导体封装行业钻石模型分析

- 一、生产要素
- 二、需求条件
- 三、支援与相关产业
- 四、企业战略、结构与竞争状态
- 五、政府的作用

第七章2018-2022年中国半导体封装行业需求特点与动态分析

第一节 中国半导体封装行业消费市场动态情况

第二节 中国半导体封装行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节 半导体封装行业成本结构分析

第四节 半导体封装行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、渠道因素
- 四、其他因素

第五节 中国半导体封装行业价格现状分析

第六节 中国半导体封装行业平均价格走势预测

- 一、中国半导体封装行业价格影响因素
- 二、中国半导体封装行业平均价格走势预测
- 三、中国半导体封装行业平均价格增速预测

第八章2018-2022年中国半导体封装行业区域市场现状分析

第一节 中国半导体封装行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区半导体封装市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区半导体封装市场规模分析
- 四、华东地区半导体封装市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析

三、华中地区半导体封装市场规模分析

四、华中地区半导体封装市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区半导体封装市场规模分析

四、华南地区半导体封装市场规模预测

第五节 华北地区半导体封装市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区半导体封装市场规模分析

四、华北地区半导体封装市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区半导体封装市场规模分析

四、东北地区半导体封装市场规模预测

第七节 西部地区市场分析

一、西部地区概述

二、西部地区经济环境分析

三、西部地区半导体封装市场规模分析

四、西部地区半导体封装市场规模预测

第九章2018-2022年中国半导体封装行业竞争情况

第一节 中国半导体封装行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国半导体封装行业SCP分析

一、理论介绍

二、SCP范式

三、SCP分析框架

第三节 中国半导体封装行业竞争环境分析（PEST）

- 一、政策环境
- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

第十章 半导体封装行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析
- 四、公司优劣势分析

第二节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第十一章2022-2027年中国半导体封装行业发展前景分析与预测

第一节 中国半导体封装行业未来发展前景分析

一、半导体封装行业国内投资环境分析

二、中国半导体封装行业市场机会分析

三、中国半导体封装行业投资增速预测

第二节 中国半导体封装行业未来发展趋势预测

第三节 中国半导体封装行业市场发展预测

一、中国半导体封装行业市场规模预测

二、中国半导体封装行业市场规模增速预测

三、中国半导体封装行业产值规模预测

四、中国半导体封装行业产值增速预测

五、中国半导体封装行业供需情况预测

第四节 中国半导体封装行业盈利走势预测

一、中国半导体封装行业毛利润同比增速预测

二、中国半导体封装行业利润总额同比增速预测

第十二章2022-2027年中国半导体封装行业投资风险与营销分析

第一节 半导体封装行业投资风险分析

一、半导体封装行业政策风险分析

二、半导体封装行业技术风险分析

三、半导体封装行业竞争风险

四、半导体封装行业其他风险分析

第二节 半导体封装行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章2022-2027年中国半导体封装行业发展战略及规划建议

第一节 中国半导体封装行业品牌战略分析

一、半导体封装企业品牌的重要性

二、半导体封装企业实施品牌战略的意义

三、半导体封装企业品牌的现状分析

四、半导体封装企业的品牌战略

五、半导体封装品牌战略管理的策略

第二节 中国半导体封装行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国半导体封装行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2022-2027年中国半导体封装行业发展策略及投资建议

第一节 中国半导体封装行业产品策略分析

一、服务/产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国半导体封装行业营销渠道策略

一、半导体封装行业渠道选择策略

二、半导体封装行业营销策略

第三节 中国半导体封装行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国半导体封装行业重点投资区域分析

二、中国半导体封装行业重点投资产品分析

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202112/566191.html>